

인도 전자부품제조계획(ECMS) 추진 현황과 시사점

강반디 세계지역연구2센터 인도남아시아팀 전문연구원 (bdkang@kiep.go.kr, 044-414-1076)



차 례

1. PLI 정책의 성과와 한계
2. ECMS의 주요 내용 및 추진 현황
3. 평가 및 시사점

주요 내용

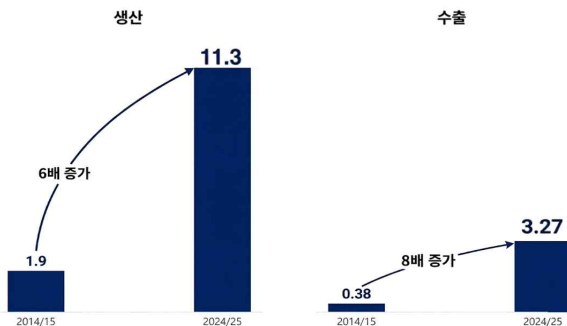
- ▶ 인도는 2014년 'Make in India' 이니셔티브 출범 이후 제조업 육성을 핵심 국가 전략으로 추진해왔으며, 2020년부터 생산 연계 인센티브(PLI: Production Linked Incentive)를 도입해 전자제품 생산과 수출 부문에서 모두 빠른 성장을 달성하였음.
 - [성과] 전자제품 생산액은 FY 14/15년 1.9조 루피에서 FY 24/25년 11.3조 루피로 약 6배 증가하였으며, 동 기간 수출액은 0.38조 루피에서 3.27조 루피로 약 8배 증가함.
 - [한계] 그러나 완제품 생산 확대에 따라 전자부품 수입도 함께 증가하였으며, 인도 내 전자부품 생산액은 FY 14/15년 0.4조 루피에서 FY24/25년 0.9조 루피로 약 2.4배 증가하는 데 그침.
- ▶ 이에 인도정부는 2025년 4월 전자부품제조계획(ECMS: Electronics Component Manufacturing Scheme)을 발표하고, 핵심 전자부품의 국내 생산 기반 구축을 통한 공급망 내재화를 추진하고 있음.
 - [추진 현황] ECMS의 총사업비(6년)는 출범 당시 약 2,292억 루피로 책정되었으나, FY 26/27년 연방 예산에서 약 4,000억 루피로 약 75% 증액되었으며, 2026년 3월까지 총 75개 프로젝트가 승인됨.
 - [지원 범위] 승인 품목은 카메라 모듈·인쇄회로기판(PCB)과 같은 부분 조립품·기본 부품부터 통신·산업용 전자부품, 디스플레이·배터리·외장재, 수동소자·회로류 자석·자본재 등 고부가 부품·소재와 제조 설비로 까지 확대됨.
- ▶ 한국 기업 및 정부는 인도의 전자부품 육성 정책을 현지 공급망 참여와 산업협력 기회로 활용할 필요가 있음.
 - [정책 전환] ECMS는 인도 전자산업 정책의 중심이 완제품 조립·생산에서 전자부품 공급망 생태계 구축으로 이동하고 있음을 보여주는 중요한 정책적 분기점으로 평가됨.
 - [한국기업] 향후 인도 내 부품 현지 생산 및 조달 수요가 확대될 가능성이 큰 만큼, 한국 전자부품 기업도 인도의 부품 생산·공급망 구축 과정에 직접 참여하는 방안을 검토해 볼 수 있음.
 - [한국정부] 인도 내 인프라·인허가·인력 리스크를 고려해 한국 기업·협력사·지원기관이 함께 진입할 수 있는 패키지형 협력 모델과 권역별 협력 거점 전략을 구체화할 필요가 있음.

1. PLI 정책의 성과와 한계

- 인도는 2014년 ‘Make in India’ 이니셔티브 출범 이후 제조업 육성을 핵심 국가 전략으로 추진해왔으며, 2020년부터는 생산 연계 인센티브(PLI: Production Linked Incentive)를 도입해 전자제품 생산과 수출 부문에서 모두 빠른 성장을 달성하였음.
- PLI는 국내 제조 규모 확대, 투자 유치, 글로벌 경쟁력 강화를 추진하는 제조업 육성 정책으로, 전체 인센티브¹⁾ 규모는 1.97조 루피(약 230억 달러)에 달함.
 - 2020년 4월 휴대전화 및 특정 전자부품, 의약품 원료, 의료기기 분야에 처음 도입된 이후 14개 전략 부문으로 확대되었으며, 2025년 8월 기준 총 806건의 신청이 승인됨.
 - PLI 도입 이후 전자산업의 생산·수출이 빠르게 증가하면서, 전자제품은 FY²⁾ 21/22년 인도 수출 품목 7위에서 FY 24/25년 3위까지 상승함.³⁾
 - 전자제품 생산액은 FY 14/15년 1.9조 루피에서 FY 24/25년 11.3조 루피로 약 6배 증가하였고, 수출액도 FY 14/15년 0.38조 루피에서 FY 24/25년 3.27조 루피로 약 8배 증가함(그림 1 참고).⁴⁾
 - 특히 휴대폰 산업은 전자산업 성장을 견인한 핵심 분야로, PLI 정책의 대표적 성과로 평가받고 있음.⁵⁾
 - 휴대폰 생산액은 지난 10년간 약 28배, 수출은 약 127배 증가함(그림 2 참고).
 - 휴대폰 제조공장 수도 FY 14/15년 2개에서 FY 24/25년 300개 이상으로 확대됨.

그림 1. 인도 전자제품 생산액 및 수출액 비교
(FY 14/15 vs FY 24/25)

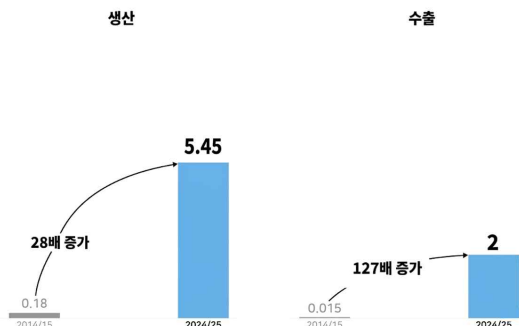
(단위: 조 루피)



주: 회계연도(Financial Year) 기준.
자료: 인도 전자정보기술부(2025. 8. 6.).⁶⁾

그림 2. 인도 휴대폰 생산액 및 수출액 비교
(FY 14/15 vs FY 24/25)

(단위: 조 루피)



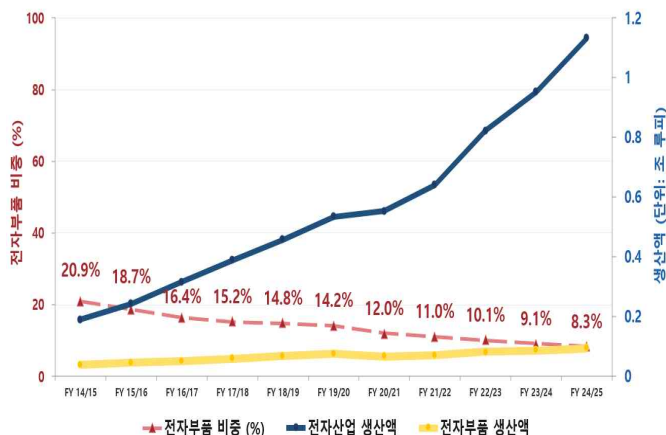
주: 회계연도(Financial Year) 기준.
자료: 인도 전자정보기술부(2025. 8. 6.).

- 1) 인센티브는 생산 증가와 추가 매출 등 측정 가능한 성과에 연계되어 지급되며, 산업별로 세부 기준과 지원 기간은 다르게 설계된다. 인도 정부(2025. 8. 24.), “PLI Scheme: Powering India’s Industrial Renaissance.”
- 2) 인도의 회계연도(Financial Year)는 매년 4월 1일부터 다음 해 3월 31일까지를 기준으로 운영된다. FY 21/22년은 2021년 4월 1일부터 2022년 3월 31일까지이며, FY 24/25는 2024년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지이다.
- 3) PIB Backgrounder(2025. 10. 27.), “Driving India’s Electronics Future.”
- 4) 인도 전자정보기술부(2025. 4. 26.), “Union Minister Ashwini Vaishnaw Launches Guidelines and Portal for Electronics Component Manufacturing scheme.”
- 5) 인도 전자정보기술부(2026. 4. 1.), “Domestic value addition in electronics manufacturing has improved significantly over the years: currently at 18%-20%.”

■ 그러나 이러한 전자산업의 양적 성장에도 불구하고 인도 전자부품 생산은 제한적인 수준에 머무르고 있음.

- 전자산업 총생산액이 지난 10년간 약 6배 증가한 데 비해, 전자부품 생산액은 FY 14/15년 0.4조 루피에서 FY24/25년 0.9조 루피로 약 2.4배 증가하는 데 그침(그림 3 참고).
 - 전자산업 총생산액에서 전자부품이 차지하는 비중은 FY 14/15년 20.9%에서 FY 24/25년 8.3%로 하락함.
- 휴대폰 생산 확대와 함께 관련 부품 수입도 증가하고 있음(표 1 참고).
 - FY 24/25년 기준 기타 전화기 부품(HS 851779) 수입액은 약 1.29조 루피로, 휴대폰 생산액(약 5.45조 루피)의 약 24% 수준에 달함.
 - 배터리, 외장재, 디스플레이·카메라 모듈, 인쇄회로기판(PCB) 등 주요 전자부품 수입액도 전년(FY 23/24) 대비 증가함.

그림 3. 인도 전자산업·전자부품 생산액과 부품 비중 변화
(단위: 조 루피, %)



주: 회계연도(Financial Year) 기준.

자료: 인도 전자정보기술부 연도별 발표 자료를 바탕으로 저자 작성.

표 1. 인도 주요 전자제품 수입액 비교
(단위: 억 루피, %)

구분	FY 23/24	FY 24/25	증가율
기타 전화기 부품 (HS 851779)	9,102	12,884	▲41.6%
리튬이온 배터리 (HS 850760)	2,435	2,546	▲4.6%
노트북/PC 부품·외장재 (HS 847330)	2,008	2,280	▲13.6%
디스플레이 모듈 등 (HS 852412)	720	1,854	▲157.5%
카메라 모듈 등 (HS 852589)	1,512	1,647	▲8.9%
인쇄회로기판(PCB 등) (HS 853400)	1,131	1,277	▲12.9%

주: 회계연도(Financial Year) 기준.

자료: 인도 상공부 통계 자료를 토대로 저자 작성.

■ 이에 인도정부는 2025년 4월 전자부품제조계획(ECMS: Electronics Component Manufacturing Scheme)을 발표하고, 핵심 전자부품의 공급망 내재화를 추진하고 있음.

- ECMS는 전자부품 및 연계 공급망의 국내 생산 기반 구축을 지원하는 정책으로, 전자산업의 부가가치 비율을 현재 약 20%에서 향후 5년 내 30~35% 수준으로 확대하는 것을 목표로 함.⁸⁾

■ 본고는 ECMS 출범 이후 1년간 추진된 사업 현황과 주요 특징을 살펴보고, 인도의 전자부품 내재화 정책이 한국 기업과 정부에 갖는 시사점을 도출하고자 함.

6) 인도 전자정보기술부(2025. 8. 6.), "LOK SABHA UNSTARRED QUESTION NO. 2950- PLI FOR ELECTRONICS AND SEMICONDUCTORS," https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU2950_wssjkG.pdf?source=pqals.

7) 인도 상공부. https://tradestat.commerce.gov.in/eidb/commodity_wise_import.

8) The Economic Times(2025. 3. 29.), "Will reach 35% value addition in electronics in five years: Ashwini Vaishnaw."

2. ECMS의 주요 내용 및 추진 현황

가. 주요 내용

■ 2025년 4월 8일, 인도정부는 전자부품제조계획(ECMS)을 발표하고, 전자부품·소재·제조 설비 분야의 자국 내 생산 기반 구축을 위한 구체적인 지원 방안을 제시함.

- [목표] 전자부품 제조 생태계 구축을 통해 핵심 부품의 수입 의존도를 완화하고, 인도의 역할을 완제품 조립 거점에서 전자부품 생산 거점으로 확대하고자 함.
- [예산] ECMS의 총사업비(6년)는 출범 당시 약 2,292억 루피(약 27억 달러)였으나, FY 26/27 예산안에서 4,000억 루피(약 47억 달러)로 확대되어 예산 규모가 약 75% 확대됨.
- [대상] 디스플레이·카메라 모듈, 인쇄회로기판(PCB) 등 총 5개 분야 12개 품목을 지원함(표 2 참고).
- [지원 방식] 기업 유형과 품목 특성에 따라 매출 연계 인센티브, 설비투자 인센티브, 또는 두 방식을 결합한 혼합형 인센티브를 적용함.
 - 매출 연계 인센티브(Turnover-linked incentive): 총 6년간(준비 기간 1년 포함) 시행되며, 기준연도 대비 증가 매출의 일정 비율을 지원하여 생산 확대를 유도
 - 설비투자 인센티브(CAPEX incentive): 총 5년간 시행되며, 적격 자본지출에 대한 직접 지원을 통해 초기 투자 부담을 완화
 - 혼합 인센티브 (Hybrid incentive): 매출 연계와 설비투자 지원을 결합하여 생산 확대와 설비투자를 동시에 유도

표 2. 전자부품제조계획(ECMS) 주요 지원 대상

구분	내용	지원 방식
[A] 부분 조립품 (Sub-assemblies)	1. 디스플레이 모듈 부분 조립품 2. 카메라 모듈 부분 조립품	매출 연계 인센티브
[B] 기본 부품 (Bare components)	3. 비표면실장형(Non-Surface Mount Devices) 수동소자 4. 전기기계(Electro-Mechanicals) 부품 5. 다층 인쇄회로기판(Multi-Layer PCB) 6. 디지털용 리튬이온 셀(저장장치 및 모빌리티용 제외) 7. 모바일, IT 하드웨어 및 관련 기기용 외장재	
[C] 선정된 기본 부품 (Selected bare components)	8. 고밀도 상호연결(High Density Interconnect) 기판, 복합 센서(Multi-Sensor), 연성회로기판(Flexible PCB) 9. 표면 실장형(Surface Mount Devices) 수동소자	
[D] 공급망 생태계 및 설비 (Supply chain ecosystem and Capital equipment)	10. A(부분 조립품) & B·C(기본 부품)의 공급망 11. 전자 제조에 사용되는 자본재(Capital Goods) 및 해당 설비의 부분 조립품·부품	설비투자 인센티브
[E] 부분 조립품 - 통신	12. 광트랜시버 - SFP(Small form-factor pluggable)	매출 연계 인센티브

자료: 인도 전자정보기술부(2025. 4. 8.), “Gazette Notification – Electronics Component Manufacturing Scheme” 및 ECMS 홈페이지 자료를 토대로 저자 작성.

9) ECMS 공식 홈페이지, <https://ecms.meity.gov.in/> “Scheme Guidelines for Electronics Component Manufacturing Scheme.”

나. 추진 현황

■ 2025년 4월 ECMS 도입 이후 총 4차에 걸쳐 75개 프로젝트가 승인되었으며, 2026년 5월 기준 누적 투자 약정 규모는 약 6,167억 루피로 당초 목표액(5,935억 루피)을 초과 달성함.

- 승인 품목은 부분 조립품, 기본 부품, 소재·제조 장비 등 전자부품 공급망 전반에 걸쳐 분포함.
- 1차 승인에서는 기본 부품·부분 조립품 중심이었던 지원 대상이 2차 통신·산업용 전자부품, 3차 디스플레이·배터리·외장재, 4차 수동소자·커넥터 등 핵심 부품·소재·자본재 분야로 확대됨(표 3 참고).

표 3. 전자부품제조계획(ECMS) 프로젝트 승인 현황(1차~4차)

구분	승인일자	프로젝트 수	예상 투자액 (억 루피)	주요 특징
1차	2025. 10. 27.	7건	553.2	- [참여 기업] 인도 로컬 기업 중심 참여 - [승인 품목] 카메라 모듈·PCB·HDI 중심
2차	2025. 11. 17.	17건	717.2	- [참여 기업] 외국계 부품기업 참여 - [승인 품목] 광트랜시버·오실레이터·커넥터 등
3차	2026. 1. 2.	22건	4,186.3	- [참여 기업] 인도 대기업과 글로벌 대기업 참여 - [승인 품목] 디스플레이·외장재·배터리·소재 등
4차	2026. 3. 30.	29건	710.4	- [참여 기업] 글로벌 부품·소재 선도기업 참여 - [승인 품목] 수동소자·커넥터·회로류 자석·자본재 등

자료: 인도정부 발표 자료¹⁰⁾를 토대로 저자 작성.

■ [1차 승인] 인도 로컬 기업을 중심으로 카메라 모듈·PCB·HDI 등 기초 전자부품 생산 기반 구축에 착수

- 인도기업인 Kaynes Circuits India는 카메라 모듈 부분 조립품, 다층 인쇄회로기판(PCB), 고밀도 상호연결(HDI) 기판 등 전체 7개 프로젝트 중 4개 프로젝트를 승인받았으며, 투자 약정 규모는 1차 승인된 전체 예상 투자액의 약 59%를 차지함.
- Syrma Strategic Electronics, Ascent Circuits 등 인도기업들도 PCB 생산 프로젝트를 승인받으며 로컬 기업을 중심으로 한 기본 전자부품의 생산 기반 구축이 추진됨.

■ [2차 승인] 통신·산업용 전자부품 분야로 승인 품목이 확대되었으며, 외국계 기업의 참여가 시작됨.

- Jabil Circuit India(미국)와 Zetchem Supply Chain Services(인도)는 인도 최초의 광트랜시버(SFP) 생산 프로젝트를 승인받으며 광통신용 부품의 현지 생산 기반 구축에 나섬.
- Rakon India(뉴질랜드, 오실레이터), TE Connectivity India(아일랜드, 커넥터) 등이 참여하면서 승인 품목이 산업용 전자부품 분야로 확대됨.

10) PIB Backgrounder(2025. 10. 27.), "Driving India's Electronics Future"; 전자정보기술부(2025. 10. 27.), "Government of India approves first batch of seven projects with investment of over ₹5500 crores under Electronics Manufacturing Component Scheme"; 전자정보기술부(2025. 11. 17.), "India announces 2nd tranche of 17 approvals under Electronics Component Manufacturing Scheme (ECMS)"; 전자정보기술부(2026. 1. 2.), "Government approves 22 proposals under the 3rd tranche of Electronics Component Manufacturing Scheme (ECMS)"; PIB Backgrounder(2026. 2. 3.), "Electronics Components Manufacturing Scheme"; 전자정보기술부(2026. 3. 30.), "Government approves 29 more proposals under the Electronics Component Manufacturing Scheme (ECMS)."

■ [3차 승인] 인도 및 글로벌 대기업의 참여가 본격화되면서 단일 차수 기준 최대 규모의 투자가 승인되었으며, 승인 품목도 디스플레이·외장재·배터리·소재 분야로 확대됨.

- 삼성디스플레이(Samsung Display Noida)는 디스플레이 모듈 부분 조립품(Display Module Sub-Assembly) 생산 프로젝트를 승인받음.
 - 이번 승인을 통해 삼성디스플레이는 기존 스마트폰용 패널 생산¹¹⁾에 더해, 현지 생산 영역을 확대하며 인도 내 스마트폰 공급망 강화에 나설 것으로 보임.
- Foxconn(대만) 계열 Yuzhan Technology를 비롯한 Apple 공급망 관련 기업들이 다수 참여하면서 스마트폰 생산의 현지화 범위가 완제품 조립에서 부품·소재 단계로 확대됨.
 - Tata Electronics(인도), Motherson Electronic Components(인도), ATL Battery Technology India (일본 TDK 자회사¹²⁾), Hindalco(인도) 등 애플 인도 생산망과 연계된 주요 공급업체 5개 사의 투자 약정 규모는 ECMS 3차에 승인된 전체 예상 투자액의 약 73%를 차지함.¹³⁾
 - 특히 인도의 대표적인 알루미늄 생산업체 Hindalco는 3차 ECMS 승인을 통해 현재 전량 수입에 의존하고 있는 알루미늄 압출재 분야에 진입하였으며,¹⁴⁾ 이는 인도정부가 자국 대기업을 통해 휴대폰 외장 재용 소재 부문 수입 의존도를 낮추려 하는 정책 방향을 보여줌.

■ [4차 승인] 글로벌 부품기업의 참여가 확대되는 한편, 인도 최초 생산 프로젝트도 다수 포함되며 ECMS의 지원 범위가 수동소자·소재·전자 제조용 자본재 영역으로 확대됨.¹⁵⁾

- 4차 승인에서는 TDK(일본, 인덕터), Vishay(미국, 수동 커패시터), Molex(미국, 커넥터), Amphenol(미국, 커넥터) 등 수동소자 및 커넥터 부분의 글로벌 선도기업이 다수 참여함.
- 이와 함께 연성회로기판, 히토류 영구자석, 탄탈륨 기반 표면실장형(SMD) 수동소자 등 그동안 현지 생산 기반이 취약했던 품목에서도 인도 최초 생산 프로젝트가 다수 승인됨.
 - [연성회로기판] Syrma Strategic Electronics는 인도 최초의 연성회로기판(Flexible PCB) 생산 프로젝트를 승인받으며 고부가 전자기기용 회로기판의 국내 생산 기반 구축에 나섬.
 - [히토류 자석] Lohum Cleantech는 인도 최초의 히토류 영구자석 생산 프로젝트를 승인받으며 전자·전기기기 및 첨단 제조업에 활용되는 핵심 소재 분야로 지원 범위가 확대됨.
 - [수동소자] 인도 최초의 탄탈륨 기반 표면실장형(SMD) 수동소자 생산 시설에 대한 지원도 승인됨.
- 이 외에도 전자 제조용 자본재 부문에서 총 6건의 프로젝트가 승인되며 지원 범위가 제조 설비 기반 확충까지 확대되었음.

11) 삼성디스플레이는 2020년 노이다(Noida)에 약 7억 달러를 투자해 제조시설을 구축하였으며, 2021년부터 스마트폰 패널을 생산 해오고 있다. 동아일보(2020. 6. 17.), 「삼성디스플레이, 인도 스마트폰 패널 공장 건설에 7억 달러 투자」; 아시아경제(2021. 4. 20.), 「삼성디스플레이, 인도 공장에서 스마트폰용 패널 생산 시작」.

12) 1999년 설립된 ATL(Ampere Technology Limited)은 홍콩에 본사를 둔 리튬이온 배터리 기업으로, 2005년 일본 TDK에 인수되어 현재 TDK의 자회사로 운영되고 있다. EETimes(2025. 6. 1.), “TDK acquires Hong Kong battery maker.”

13) Business Standard(2026. 1. 2.), “Apple leads ECMS drive, ties up with five anchor vendors for India ops.”

14) 전자정보기술부(2026. 1. 2.), “Government approves 22 proposals under the 3rd tranche of Electronics Component Manufacturing Scheme (ECMS).”

15) 전자정보기술부(2026. 3. 30.), “Government approves 29 more proposals under the Electronics Component Manufacturing Scheme (ECMS).”

3. 평가 및 시사점

가. 평가

■ [정책 전환] ECMS는 인도 전자산업 정책의 중심이 완제품 조립·생산에서 전자부품 공급망 생태계 구축으로 이동하고 있음을 보여주는 중요한 정책적 분기점으로 평가됨.

- [공급망 구축] 기존 PLI가 완제품 생산 확대에 중점을 두었다면, ECMS는 수입 의존도가 높은 전자부품 생산을 직접 지원하고 소재·제조 설비까지 지원 범위를 확대하여 공급망 생태계의 내재화를 추진함.
 - [지원수단 다변화] PLI가 생산 실적과 연계하여 인센티브를 지급한 것과 달리, ECMS는 생산뿐만 아니라 설비투자 인센티브를 병행 지원하며 생산 확대와 시설 투자를 동시에 유도함.
- [발전 단계 전환] 후발국 전자산업의 발전 단계가 조립 → 부품·소재 내재화 → 자체 설계·브랜드 구축 경로를 거친다는 점에서, ECMS는 인도가 부품·소재 내재화 단계로 이행하기 위한 정책적 시도로 해석할 수 있음.

■ [투자 유치 기반 확대] 인도정부는 ECMS를 통한 재정 지원과 FDI 제도 개정을 병행하며, 전자부품 공급망 내재화에 필요한 외국 자본·기술 유입 여건을 보완하고 있음.

- ECMS 예산만으로 공급망 내재화에 필요한 대규모 투자를 충당하기에는 한계가 있는 만큼, 인도정부는 2026년 3월 FDI 제도 개정(PN2: Press Note No. 2)을 통해 전자부품·자본재 분야의 외국인 투자 유치 여건을 개선하였음.
 - 이전에는 인도 육상접경국(Countries sharing Land Border)의 모든 투자가 인도정부의 사전 승인 대상이었으나, 제도 개편 이후 육상접경국 최종수익자(Beneficial Owner)의 지분이 10% 이하인 경우 정부 승인 없이 투자할 수 있게 됨.¹⁶⁾
 - 자본재, 전자 제조용 자본재, 전자부품, 폴리실리콘, 잉곳·웨이퍼 분야에 대해서는 60일 이내 심사 프로세스를 적용하여 핵심 제조업 분야의 외국인 투자 승인 절차를 단축함.
- 다만 PN2는 인도 거주자의 과반 지분 유지 등 국내 통제 장치를 병행함으로써 인도 측 영향력을 유지한 상태에서 외국 자본·기술 유입을 허용하고 있음.

■ [제약 요인] 전자부품 산업은 기술 확보, 소재·장비 조달, 숙련 인력 양성이 동시에 요구되는 분야로, 인도가 해당 부문의 역량을 단기간 내 확보하기는 쉽지 않을 것으로 보임.

- 전자부품 산업은 완제품 조립과 달리 기술 집약도와 소재·장비 의존도가 높아 투자 확대가 곧바로 기술 자립으로 이어지기 어려움.

16) 인도 내각(2026. 3. 10.), "Cabinet approves changes in guidelines on investments from countries sharing land border with India."

- 주요 전자부품의 글로벌 공급망이 중국·대만·한국·일본을 중심으로 형성되어 있는 상황에서 핵심 기술 이전은 제한적으로 이루어질 가능성이 높음.
- 인력 측면에서도 정밀 부품·소자 제조에 필요한 숙련 기술 인력 공급이 주요 과제로 제기되고 있으나, 관련 인력 기반은 교육·훈련과 현장 경험 축적을 필요로 해 단기간 내 확충에는 한계가 있을 것으로 보임.
- ECMS가 지원하는 정밀 부품·소자 제조는 완제품 조립보다 높은 숙련도를 요구하나, 이를 뒷받침할 인력 기반과 훈련 인프라 등이 아직 충분히 형성되지 않은 상황임.
- 인도정부는 2026년 3월 ECMS 참여 기업에 인력 양성을 포함한 역량 강화를 요구하며, 해당 부문의 준비가 미흡할 경우 지원 대상에서 배제될 수 있다고 경고한 바 있음.¹⁷⁾

■ [성과 전망] ECMS는 단기적으로 일부 품목의 현지 생산 확대를 견인할 수 있으나, 향후 실제 부가가치 창출로 연결되기 위해서는 승인·투자 성과가 생산 기반 정착과 공급망 연계로 이어져야 함.

- 단기적으로는 PCB, 외장재, 카메라 모듈 등 완제품 생산과 직접 연계되는 품목에서 점진적으로 내재화 성과가 나타날 가능성이 높음.
- 소재·장비·고부가 부품 분야는 공정 기술 확보, 품질 검증, 전문 인력 축적이 요구되므로 성과 가시화에는 더 긴 시간이 소요될 것으로 보임.
- 중국도 과거 제조업 고도화를 위해 외국 기술·자본 유치와 자국 기업 육성을 병행 추진했던 바 있으나, 실제 산업 기반 구축에는 수십 년이 소요되었음.¹⁸⁾
- 현재까지의 성과는 대부분 승인과 투자 약정 단계에 머물러 있어, 향후 실제 생산 개시와 양산 전환 여부를 지속적으로 점검할 필요가 있음.
- ECMS 추진이 실질적인 부가가치 창출로 이어지기 위해서는 단순 설비 확충을 넘어 전문 인력과 기술 역량 축적, 양산 체계 구축, 현지 조달 확대와 글로벌 납품망 연계 등이 병행될 필요가 있음.

나. 시사점

■ [기업] 향후 인도 내 부품 현지 생산 및 조달 수요가 확대될 가능성이 큰 만큼, 한국 전자부품 기업도 인도의 부품 생산·공급망 구축 과정에 직접 참여하는 방안을 검토해 볼 수 있음.

- [공급망 참여 기회] ECMS 승인 이후 관련 기업들이 생산설비 및 조달 체계 구축에 착수하면서, 인도 내 부품 생산·공급망 형성과 협력사 발굴 수요가 확대될 것으로 보임.
- 중장기적으로는 인도정부의 부품 현지화 정책 기조에 따라 핵심 부품·소재의 현지 조달 요구가 강화될 가능성이 높음.

17) Business Standard(2026. 3. 30.), "Govt may stop ECMS funds if design, Six Sigma quality not met: Vaishnav."

18) 중국은 개혁·개방 이후 약 20년간 산업기술 개발과 외국 선진기술 도입을 추진했음에도 불구하고, 2000년대 초반까지 첨단산업 등 기술집약 산업의 발전은 제한적이었다. 이후 2001년 WTO 가입과 2002년 「국가 산업기술 정책」 발표를 계기로 산업기술 고도화와 자주혁신 전략이 본격화되면서 첨단 제조업 및 기술집약 산업의 발전이 가속화되었다. 최원석 외(2020), 「개혁·개방 이후 중국의 제조업 분야 산업정책과 산업구조 변화 연구」, pp. 157~164, 대외경제정책연구원.

- [경쟁 환경 변화] 글로벌 부품기업의 ECMS 참여는 인도 전자부품 시장을 둘러싼 글로벌 전자부품·모듈 기업의 관심이 높아지고 있음을 시사함.
 - 2차~4차 승인 대상에 미국 Jabil·Vishay·Molex·Amphenol, 대만 Foxconn 계열사, 일본 TDK 등이 포함되며, 인도 내 부품 공급망 선점을 둘러싼 경쟁이 본격화되고 있음.
- [현지 협력 수요 확대] 인도기업들도 전자부품 제조에 필요한 기술·자본 역량을 보완하기 위해 외국 기업과의 협력을 확대하고 있음.
 - 인도 Dixon Technologies는 중국 HKC Overseas와 디스플레이 모듈 생산을 위한 합작법인을 설립했고, Syrma SGS는 한국 신협전자와 인쇄회로기판(PCB) 제조를 위한 합작법인을 설립함.¹⁹⁾
- 인도 내 전자부품 공급망이 형성되는 초기 국면에서 한국기업이 주요 수요처와의 거래 기반 및 현지 기업과의 협력 관계를 구축할 경우, 향후 확대될 인도 전자부품 시장에 대한 접근성을 높이고 공급망 내 입지를 강화할 수 있음.
 - 한국 전자부품 기업은 ECMS 승인 기업, 완제품 제조기업, 인도 현지 기업 등과의 공급 협력 및 품목 매칭을 통해 초기 참여 가능성을 검토하고, 수요·파트너 조건에 따라 공정·품질관리 협력, 기술 협력, 합작투자나 전략적 파트너십으로 협력 수준을 확대할 수 있음.
 - 다만 현지 생산거점 구축을 수반하는 진출의 경우, 인도 내 인프라·인허가·인력 리스크를 고려해 개별 중소기업의 단독 진출보다는 완제품 제조기업 연계형, 현지 파트너십 기반 또는 정부 간 협력 플랫폼을 활용한 접근이 보다 현실적인 대안으로 판단됨.

■ [정부] 한국기업의 인도 현지 공급망 참여가 확대되기 위해서는 개별 기업 차원의 진출 전략을 넘어, 정부 차원의 통합형 지원 체계를 구축할 필요가 있음.

- [협력 모델] 한국정부는 일본의 대인도 진출 사례를 참고해 산업단지·인프라·인력 양성·행정 지원을 결합한 패키지형 협력 모델을 검토할 필요가 있음.
 - 일본은 전용 산업단지(JIT: Japanese Industrial Townships), 현지 행정 지원, 제조업 인력 양성²⁰⁾을 연계하여 자국 기업의 인도 진출을 지원해오고 있음.
 - 한국도 KOICA를 통해 인도 내 제조업 숙련 인력 양성을 위한 협력 기반을 마련하고 있으나, 아직은 인력 양성 분야의 개별 사업으로 추진되고 있음.²¹⁾
 - 한국정부는 향후 인력 양성 협력을 기업 진출 지원 체계와 연계하여 지원 방향을 기업·협력사·지원기관의 공동 진출을 지원하는 단계적·패키지형 접근 방식으로 확장할 필요가 있음.²²⁾

19) Nikkei Asia(2026. 4. 13.), "India increases use of foreign players to move up electronics value chain."

20) 일본은 JIM(Japan-India Institute for Manufacturing)과 JEC(Japanese Endowed Courses)를 통해 인도 내 제조업 인력 양성을 지원하고 있다. JIM은 일본기업이 직접 운영하는 현장 리더 양성 과정이며, JEC는 공과대학 내 실무 중심 교육과정을 통해 엔지니어·중간관리자 인력을 양성하는 방식이다. 운영 과정에서 일본기업은 장비·강사·채용 연계를 제공하고, 일본정부는 인증·교재·강사 파견을 지원하며, 인도 중앙·주정부는 자격 승인, 부지·시설 제공, 운영비 지원 등을 담당한다. 日 경제산업성(METI, 2024. 8.), "Human Resource Development in the Manufacturing Sector in India."

21) KOICA는 2025년 1월 인도정부와 '인도 메카트로닉스 직업기술교육 역량강화 사업'에 합의하고, 마이스터고 모델을 토대로 마디아프라데시주 보팔에서 제조업 숙련인력 양성을 지원하고 있다. KOICA(2026. 1. 21.), 「'인도 기술인력 역량 강화' 한-인도 양국 간 개발협력 파트너십 새 이정표」.

22) 단기적으로는 KOTRA·KITA 등 유관 기관이 인도 진출 검토 중소기업에 유망 산업단지 정보와 현지 기관 네트워킹 기회를 제공하고,

- [협력 거점] ECMS 승인 프로젝트가 남부·서부·북부 주요 주(州)를 중심으로 승인이 이루어지고 있어,²³⁾ 한국도 권역별 승인 품목과 산업 기반을 고려한 협력 거점 선별이 필요함.
 - 인도 내 남부권(타밀나두·카르나타카·안드라프라데시), 서부권(마하라슈트라·구자라트·고아), 북부권(우타르프라데시·하리아나·라자스탄 등)은 전자부품 공급망 협력 측면에서 각기 다른 강점을 보유함.²⁴⁾
 - 이 세 거점은 한국 대기업의 기존 생산 거점²⁵⁾과 상당 부분 중첩되어 있어, 향후 부품·소재 기업의 동반 진출 및 공급망 연계 측면에서 활용 가능성이 높음.
- 이를 통해 한국정부는 인도의 전자부품 육성 정책을 산업 협력 기회로 활용하고, 패키지형 협력 모델과 권역별 협력 거점 전략을 구체화함으로써 한국기업이 인도 전자부품 생태계의 주요 협력 파트너로 자리매김할 수 있도록 지원할 필요가 있음. **KIEP**

중기적으로는 인도정부와의 협의를 통해 '한국 전용 구역'을 조성하는 추진하는 방안을 검토할 수 있다. 김경훈(2026. 6. 5.), 「인도 산업단지 조성 전략 (BHAVYA)과 시사점」, KIEP 세계경제 포커스, Vol. 9, No 40, 대외경제정책연구원.

- 23) ECMS의 주별 승인 현황은 3차 승인까지만 공개되어 있으며, 3차 승인 기준 △ 남부권 25건(타밀나두 11건, 카르나타카 9건, 안드라프라데시 5건), △ 서부권 9건(마하라슈트라 7건, 구자라트·고아 각 1건), △ 북부권 8건(우타르프라데시 4건, 하리아나 3건, 라자스탄 1건), 중부권 3건(마디아프라데시), △ 북부 접경권 1건(잠무카슈미르) 등 총 46건이다. Ministry of Electronics & IT(2026. 1. 2.), "Government approves 22 proposals under the 3rd tranche of Electronics Component Manufacturing Scheme (ECMS)."
- 24) △ 남부권은 숙련 전자 인력, 항만 물류 경쟁력, OEM 투자자들의 접근성이 높아 PCB·부분조립품·EMS 기업을 중심으로 한 공급망 참여에 유리하고, △ 서부권은 소재·금속·외장재·정밀가공 분야에 적합해 수동소자·소재·부품 협력 거점으로 주목되며, △ 북부권은 노이다의 모바일 제조 기반과 연계되어 디스플레이·광학부품의 현지화가 확대될 가능성이 높다. India Briefing(2026. 1. 5.), "India Advances Electronics Manufacturing with INR 418.63 Billion Investment in New ECMS Approvals."
- 25) 북부(우타르프라데시)에 삼성 노이다·LG 그레이터노이다, 남부(타밀나두·안드라프라데시)에 삼성·현대차 첸나이 및 LG 스리시티(건설 중), 서부(마하라슈트라)에 LG 푸네가 있다.